

信頼性試験結果 Reliability Test

XC9711 シリーズ

XC9711 Series

パッケージ : HSOP-8N

RoHS対応品 / RoHS Compliance
ハロゲン&アンチモンフリー / Halogen & Antimony-Free

No.	試験項目 Test Item	試験条件 Test Conditions	時間 Hours	試験結果 Result r/n
1	高温バイアス High Temperature Bias	150°C VIN=60.0V, PG=6.2V	1000	0/22
2	高温保存 High Temperature Storage	150°C	1000	0/22
3	高温高湿バイアス Temperature Humidity Bias	85°C85%RH VIN=60.0V, FB=0.9V, PG=MODE=6.2V	1000	0/22
4	温度サイクル Temperature Cycle (Gaseous)	-65°C～150°C 各30分 30min each	100CYC.	0/22
5	プレッシャークッカーバイアス HAST	130°C85%RH 2×10^5 Pa VIN=60.0V, FB=0.9V, PG=MODE=6.2V	100	0/22
6	プレッシャークッカー UHA	130°C85%RH 2×10^5 Pa	100	0/22
6	はんだ耐熱 Resistance to Soldering Heat	85°C85%RH168h→reflow(150～200°C140sec/255°C30sec/260°C10sec)3times Moisture Sensitivity Level 1 Based on IPC/JEDEC J-STD-020	-	0/11
7	静電耐圧 Electric Static Discharge	MM R=0Ω C=200pF ±200V	3回 3 times	0/5
		HBM R=1500Ω C=100pF ±1kV	3回 3 times	0/5
		CDM ±500V	3回 3 times	0/5
8	ラッチアップ Latch-Up	E-test VIN=61.5V Pulse voltage	1回 1 time	0/5
		I-test ±100mA	1回 1 time	0/5

パッケージ代表データ

Performed with samples that represent the applicable PKG type.

No.	試験項目 Test Item	試験条件 Test Conditions	試験結果 Result r/n
1	端子引っ張り Terminal Strength	1N 10秒 1N 10s	0/5
2	はんだ付け性 Solderability	230°C10秒(プロファイル昇温法) 230°C 10s (Temperature profile method)	0/11